

广东风华高新科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资以及投资新增半导体 封装测试产品技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资及技改项目投资概述

(一)根据 公司战略发展规划及全资子公司——广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）发展需求，公司以现金人民币 13,000 万元对风华芯电进行增资，增资完成后，风华芯电注册资本增加至 20,000 万元。同时，公司同意风华芯投资 5,848.92 万元，用于实施新增年产 15 亿只 SOP/SOT 半导体封装测试产品技术改造项目（以下简称“技改项目投资”）。

(二)公司于 2013 年 12 月 25 日在广州市广晟大厦 57 楼会议室召开第七届董事会 2013 年第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资新增年产 15 亿只 SOP/SOT 半导体封装测试产品技术改造项目的议案》和《关于对全资子公司广东风华芯电科技股份有限公司进行增资的议案》。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对风华芯电的增资及风华芯电投资技改项目不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

二、风华芯电基本情况

(一) 基本资料

公司名称：广东风华芯电科技股份有限公司

住所：广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号

注册资本：人民币 7,000 万元

法定代表人：廖永忠

经营范围：生产：电子元器件及其配件。销售电子产品及通讯设备，电子元器件及其配套件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（按[2001]粤外经贸发登字第 066 号文经营）；自有物业出租。

股东情况：公司持股比例为 95.78%，公司全资子公司广州风华创业投资有限公司（以下简称“风华创投”）持股比例为 4.22%。

(二) 主要财务指标

截止 2013 年 9 月 30 日，风华芯电未经审计资产总额为 33,816.98 万元，负债总额为 26,550.19 万元，净资产为 7,266.79 万元；2013 年 1 月至 9 月累计实现营业收入 11,394.54 万元，累计实现净利润为 -1,009.44 万元。

三、本次增资和技改项目投资情况

(一) 本次增资情况

1、增资方式及金额

公司以现金 13,000 万元，按 1 元/股的价格对风华芯电进行增资。

2、增资合同的主要内容

风华芯电系公司下属全资子公司，尚未签订增资合同。

3、增资前后股权情况

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	持股数（万股）	比例（%）	持股数（万股）	比例（%）
广东风华高新科技股份有限公司	6,704.53	95.78%	19,704.53	98.53%
广州风华创业投资有限公司	295.47	4.22%	295.47	1.47%
合计	7,000	100%	20,000	100%

4、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资将进一步满足风华芯电日常经营、技改扩产等资金需求，同时将进一步优化风华芯电的财务结构，提高其抗风险能力，有利于整体提升公司半导体封装测试产品的市场竞争力，符合公司发展战略的需要。

本次增资资金来源为公司自有货币资金，增资行为未改变公司实际控股比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）技改项目投资情况

1、项目概述

（1）项目名称：新增年产 15 亿只 SOP/SOT 半导体封装测试产品技术改造项目

（2）项目实施单位：广东风华芯电科技股份有限公司

（3）项目投资金额：人民币 5,848.92 万元

（4）项目建设目标：新增 SOP/SOT 半导体封装测试产品产能 15 亿只/年

5、项目建设期：2014 年 1 月—2014 年 5 月

6、主要经济指标：项目达产后，将新增年销售收入 6,028 万元，

年新增利润总额为 671 万元，项目内部收益率约为 15.24%，动态回收期约为 4.8 年。

2、项目背景分析

公司战略目标是成为国际一流的新型电子元器件整合配套供应商，但器件与元件相比规模偏小，与潜在市场需求及竞争对手的差距仍然较大。本项目旨在通过新增投资进一步扩大生产规模，提升公司半导体封装测试产品的技术水平、盈利水平和整体配套能力。

3、项目投资具体内容

（1）项目建设产品内容

新增年产 15 亿只 SOP/SOT 半导体封装测试产品技术改造项目主要用于投资 SOP-8 和 SOT23 等产品。

（2）设备方案与厂房规划

本项目的厂房规划主要通过对现有闲置厂房进行改造装修使用，费用约为 150 万元；新增设备投资额约为 4,698.92 万元。

（3）人力资源规划

新增半导体封装测试产能 15 亿只/年的规模，需要员工约 112 名。

（4）投资方案和财务评估

项目总投资约 5,848.92 万元，其中固定资产投资 4,848.92 万元，流动资金 1,000 万元。预计项目全部达产后，年新增销售收入约为 6,028 亿元，利润总额约为 671 万元。项目所需资金由公司自筹解决。

4、项目的风险、对策及对公司的影响

（1）成本风险

本项目需用原材料主要有焊线、支架、塑封料等，近年来上述原材

料价格均有不同程度的波动。受原材料价格及人力资源成本上升等各种因素影响，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

对策：本项目投产后，将提高材料采购议价能力，从而有效控制材料采购成本；在生产过程中，随着购进新一代设备的投入使用，可进一步提高生产原材料的利用率、减少材料损耗；公司将不断加大力度对主要材料进行替代开发的研究，在保证不降低产品性能的基础上使用低成本的材料，从而控制产品材料成本，如背银芯片替代背金芯片，镍基材镀厚铜框架替代镍基材镀银框架等。

（2）市场风险

本项目市场风险主要来自于客户需求变化、市场竞争加剧、产品价格下降三个方面。

对策：半导体器件封装测试市场是一个以规模、质量和服务取胜的市场，半导体封装测试未来将继续演绎“大者恒大，强者恒强”的产业竞争格局。公司将通过加大投资力度以快速提高企业规模、降低运营成本。

公司将持续加大客户结构调整和产品结构优化力度，加大力度开拓通信、计算机、医疗、汽车电子、LED 显示及照明等行业客户；积极拓展海外市场，以形成内外均衡、行业均衡的格局。

公司将充分利用珠三角地区作为全球各式终端消费电子制造中心的不利条件，发挥地缘优势，缩短交货期及售后服务响应时间、加大技术支持力度，提高客户满意度。

（3）技术风险

本项目的技术风险主要在于核心技术人员的流失和新产品合格率低。

对策：公司将持续完善对核心研发技术人员的激励与约束机制，建

立具有吸引力和竞争力的薪酬体系，吸引和留住人才。

本项目主要用于现有产品产能的增加，公司已具备稳定的生产制程控制水平，且项目引进设备的精度、性能及稳定性均高于现有设备，将进一步确保生产工艺和产品合格率的稳定，同时，公司将进一步加大对新员工的培训考核力度，减少人为因素对合格率的影响。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十七日